

2020年中国芯片市场分析报告- 行业发展现状与发展规划研究

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国芯片市场分析报告-行业发展现状与发展规划研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/468282468282.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

【报告大纲】

第一章芯片行业的总体概述

1.1相关概念

1.1.1芯片的内涵

1.1.2集成电路的内涵

1.1.3两者的联系与区别

1.2常见类型

1.2.1LED芯片

1.2.2手机芯片

1.2.3电脑芯片

1.2.4大脑芯片

1.2.5生物芯片

1.3制作过程

1.3.1原料晶圆

1.3.2晶圆涂膜

1.3.3光刻显影

1.3.4掺杂杂质

1.3.5晶圆测试

1.3.6芯片封装

1.3.7测试包装

1.4芯片上下游产业链分析

1.4.1产业链结构

1.4.2上下游企业

第二章2016-2019年全球芯片产业发展分析

2.12016-2019年世界芯片市场综述

2.1.1市场发展历程

2.1.2销售态势分析

2.1.3市场特点分析

2.1.4市场竞争格局

2.1.5下游应用领域

2.1.6芯片设计现状

- 2.1.7芯片制造产能
- 2.1.8产业发展趋势
- 2.2美国芯片产业分析
 - 2.2.1产业发展地位
 - 2.2.2产业发展优势
 - 2.2.3政策布局加快
 - 2.2.4产业发展规模
 - 2.2.5产业发展特点
 - 2.2.6芯片市场份额
 - 2.2.7类脑芯片发展
 - 2.2.8技术研发动态
- 2.3日本芯片产业分析
 - 2.3.1产业发展历程
 - 2.3.2市场发展状况
 - 2.3.3产业发展特点
 - 2.3.4技术研发进展
 - 2.3.5企业经营情况
 - 2.3.6企业并购动态
- 2.4韩国芯片产业分析
 - 2.4.1产业发展阶段
 - 2.4.2产业发展动因
 - 2.4.3行业发展地位
 - 2.4.4出口走势分析
 - 2.4.5产业发展经验
 - 2.4.6市场发展战略
- 2.5印度芯片产业分析
 - 2.5.1产业发展优势分析
 - 2.5.2电子产业发展状况
 - 2.5.3市场需求状况分析
 - 2.5.4行业发展现状分析
 - 2.5.5行业协会布局动态
 - 2.5.6产业发展挑战分析
 - 2.5.7芯片产业发展战略

3.1经济环境分析

3.1.1国内宏观经济

3.1.2对外经济分析

3.1.3工业运行情况

3.1.4固定资产投资

3.1.5宏观经济趋势

3.2社会环境分析

3.2.1互联网加速发展

3.2.2智能芯片不断发展

3.2.3信息化发展的水平

3.2.4电子信息制造情况

3.2.5研发经费投入增长

3.2.6科技人才队伍壮大

3.2.7万物互联带来需求

3.3技术环境分析

3.3.1芯片技术研发进展

3.3.25G技术助力产业分析

3.3.3芯片技术发展方向分析

3.4专利环境分析

3.4.1全球集成电路领域专利状况

3.4.2美国集成电路领域专利状况

3.4.3中国集成电路领域专利状况

3.4.4中国集成电路布图设计专用权

第四章2016-2019年年中国芯片产业发展分析

4.12016-2019年中国芯片产业发展状况

4.1.1行业特点概述

4.1.2产业发展背景

4.1.3产业发展意义

4.1.4产业发展进程

4.1.5产业销售规模

4.1.6芯片产量规模

4.1.7产业发展提速

4.22016-2019年中国芯片市场格局分析

4.2.1企业发展状况

4.2.2区域发展格局

4.2.3市场发展形势

4.32016-2019年中国芯片国产化进程分析

4.3.1芯片国产化政策环境

4.3.2核心芯片自给率低

4.3.3产品研发制造短板

4.3.4芯片国产化率分析

4.3.5芯片国产化的进展

4.3.6芯片国产化的问题

4.3.7芯片国产化未来展望

4.4中国芯片产业发展困境分析

4.4.1市场垄断困境

4.4.2过度依赖进口

4.4.3技术短板问题

4.4.4人才短缺问题

4.5中国芯片产业应对策略分析

4.5.1突破垄断策略

4.5.2化解供给不足

4.5.3加强自主创新

4.5.4加大资源投入

第五章2016-2019年中国重点地区芯片产业发展分析

5.1广东省

5.1.1产业总体情况

5.1.2发展条件分析

5.1.3产业结构分析

5.1.4竞争格局分析

5.1.5发展机遇与挑战

5.1.6产业发展方向

5.2北京市

5.2.1产业发展优势

5.2.2产量规模状况

5.2.3市场规模状况

5.2.4产业发展规划

5.2.5典型企业案例

5.2.6典型产业园区

5.2.7重点项目动态

5.2.8产业发展困境

5.2.9产业发展对策

5.3上海市

5.3.1产业发展综况

5.3.2产量规模状况

5.3.3市场规模状况

5.3.4产业空间布局

5.3.5人才建设体系

5.3.6产业发展格局

5.3.7产业发展规划

5.4南京市

5.4.1产业发展优势

5.4.2产业规模状况

5.4.3项目投资动态

5.4.4企业布局加快

5.4.5产业发展方向

5.4.6产业发展规划

5.5厦门市

5.5.1产业发展态势

5.5.2产业发展实力

5.5.3产业发展提速

5.5.4产业规模分析

5.5.5融资合作动态

5.5.6区域发展格局

5.5.7产业发展重点

5.6晋江市

5.6.1产业发展规模

5.6.2项目建设布局

5.6.3园区建设动态

5.6.4鼓励政策发布

5.6.5产业发展规划

5.6.6人才资源保障

5.7其他城市

5.7.1合肥市

5.7.2成都市

5.7.3重庆市

5.7.4杭州市

5.7.5无锡市

5.7.6广州市

5.7.7深圳市

第六章2016-2019年中国芯片产业上游市场发展分析

6.12016-2019年中国半导体产业发展综况

6.1.1半导体产业链

6.1.2半导体材料市场

6.1.3半导体设备市场

6.22016-2019年中国半导体市场运行状况

6.2.1产业发展态势

6.2.2产业销售规模

6.2.3市场规模现状

6.2.4产业区域分布

6.2.5市场机会分析

6.32016-2019年中国芯片设计行业发展分析

6.3.1芯片设计概述

6.3.2行业发展历程

6.3.3市场发展规模

6.3.4企业数量规模

6.3.5企业地域分布

6.3.6重点企业运行

6.3.7设计人员规模

6.3.8产品领域分布

6.3.9细分市场发展

6.42016-2019年中国晶圆代工产业发展分析

6.4.1晶圆制造工艺

6.4.2行业整体发展

6.4.3行业竞争格局

6.4.4企业布局分析

6.4.5工艺制程进展

6.4.6国内重点企业

6.4.7产能规模预测

第七章2016-2019年中国芯片产业中游市场发展分析

7.1中国芯片封装测试行业发展综况

7.1.1封装技术介绍

7.1.2芯片测试原理

7.1.3测试准备规划

7.1.4主要测试分类

7.1.5关键技术突破

7.1.6发展面临的问题

7.2中国芯片封装测试市场分析

7.2.1全球市场状况

7.2.2行业竞争格局

7.2.3国内市场规模

7.2.4产业投资情况

7.2.5企业规模分析

7.2.6国内重点企业

7.2.7企业并购动态

7.3中国芯片封测行业发展前景及趋势分析

7.3.1行业发展前景

7.3.2技术发展趋势

7.3.3产业趋势分析

7.3.4产业增长预测

7.3.5运营态势预测

第八章2016-2019年中国芯片产业下游应用市场分析

8.1LED领域

8.1.1产业发展状况

8.1.2LED芯片产值

8.1.3LED芯片成本

8.1.4重点企业运营

8.1.5企业发展布局

8.1.6项目动态分析

8.1.7封装技术难点

8.1.8整体发展走势

8.1.9具体发展趋势

8.2物联网领域

8.2.1产业链的地位

8.2.2发展环境分析

8.2.3市场规模状况

8.2.4出货结构分析

8.2.5竞争主体分析

8.2.6物联网连接芯片

8.2.7典型应用产品

8.2.8芯片研发动态

8.2.9产业发展关键

8.2.10产业投资前景

8.3无人机领域

8.3.1无人机产业链

8.3.2市场规模状况

8.3.3行业融资情况

8.3.4市场竞争格局

8.3.5主流解决方案

8.3.6芯片应用领域

8.3.7市场前景趋势

8.4卫星导航领域

8.4.1北斗芯片概述

8.4.2产业发展状况

8.4.3芯片销量状况

8.4.4芯片研发进展

8.4.5融资合作动态

8.4.6产业发展趋势

8.5智能穿戴领域

8.5.1产业链构成

8.5.2产品类别分析

8.5.3市场规模状况

8.5.4市场竞争格局

8.5.5核心应用芯片

8.5.6芯片厂商对比

- 8.5.7发展潜力分析
- 8.5.8行业发展趋势
- 8.6智能手机领域
 - 8.6.1出货规模排名
 - 8.6.2智能手机芯片
 - 8.6.3产业格局概述
 - 8.6.4产品技术路线
 - 8.6.5芯片评测状况
 - 8.6.6芯片评测方案
 - 8.6.7无线充电芯片
 - 8.6.8芯片出货量规模
 - 8.6.9未来市场展望
- 8.7汽车电子领域
 - 8.7.1产业发展机遇
 - 8.7.2行业发展状况
 - 8.7.3市场规模状况
 - 8.7.4车用芯片格局
 - 8.7.5汽车电子渗透率
 - 8.7.6智能驾驶应用
 - 8.7.7未来发展前景
- 8.8生物医药领域
 - 8.8.1基因芯片介绍
 - 8.8.2市场规模状况
 - 8.8.3主要技术流程
 - 8.8.4技术应用情况
 - 8.8.5重要应用领域
 - 8.8.6重点企业分析
 - 8.8.7生物研究的应用
 - 8.8.8发展问题及前景
- 8.9通信领域
 - 8.9.1通信业总体情况
 - 8.9.2芯片应用需求
 - 8.9.3芯片应用状况
 - 8.9.45G芯片应用
 - 8.9.5产品研发动态

第九章2016-2019年创新型芯片产品发展分析

9.1计算芯片

9.1.1产品升级要求

9.1.2产品研发动态

9.1.3发展机遇分析

9.1.4发展挑战分析

9.1.5技术发展关键

9.2智能芯片

9.2.1AI芯片基本概述

9.2.2AI芯片市场规模

9.2.3AI芯片市场结构

9.2.4AI芯片区域结构

9.2.5AI芯片行业结构

9.2.6AI芯片细分领域

9.2.7企业布局AI芯片

9.2.8AI芯片政策机遇

9.2.9AI芯片厂商融资

9.2.10AI芯片发展趋势

9.3量子芯片

9.3.1技术体系对比

9.3.2市场发展形势

9.3.3产品研发动态

9.3.4未来发展前景

9.4低耗能芯片

9.4.1产品发展背景

9.4.2系统及结构优化

9.4.3器件结构分析

9.4.4低功耗芯片设计

9.4.5产品研发进展

第十章芯片上下游产业链相关企业分析

10.1芯片设计行业重点企业分析

10.1.1高通（QUALCOMM，Inc.）

10.1.2博通有限公司（Broadcom Limited）

- 10.1.3英伟达 (NVIDIA Corporation)
- 10.1.4美国超微公司 (AMD)
- 10.1.5联发科技股份有限公司
- 10.2晶圆代工行业重点企业分析
 - 10.2.1格罗方德半导体股份有限公司
 - 10.2.2台湾积体电路制造公司
 - 10.2.3联华电子股份有限公司
 - 10.2.4展讯通信有限公司
 - 10.2.5力晶科技股份有限公司
 - 10.2.6中芯国际集成电路制造有限公司
- 10.3芯片封装测试行业重点企业分析
 - 10.3.1艾马克技术公司 (Amkor Technology , Inc.)
 - 10.3.2日月光半导体制造股份有限公司
 - 10.3.3江苏长电科技股份有限公司
 - 10.3.4天水华天科技股份有限公司
 - 10.3.5通富微电子股份有限公司

第十一章2016-2019年中国芯片行业投资分析

- 11.1投资机遇分析
 - 11.1.1投资价值较高
 - 11.1.2投资需求上升
 - 11.1.3政策机遇分析
 - 11.1.4资本市场机遇
 - 11.1.5国际合作机遇
- 11.2行业投资分析
 - 11.2.1投资进程加快
 - 11.2.2阶段投资逻辑
 - 11.2.3国有资本为重
 - 11.2.4行业投资建议
- 11.3基金融资分析
 - 11.3.1基金融资需求分析
 - 11.3.2基金发展价值分析
 - 11.3.3基金投资规模状况
 - 11.3.4基金投资范围分布
 - 11.3.5基金重点布局情况

11.3.6基金未来规划方向

11.4行业并购分析

11.4.1全球产业并购现状

11.4.2全球产业并购规模

11.4.3国内产业并购特点

11.4.4企业并购动态分析

11.4.5产业并购相应对策

11.4.6市场并购趋势分析

11.5投资风险分析

11.5.1贸易政策风险

11.5.2贸易合作风险

11.5.3宏观经济风险

11.5.4技术研发风险

11.5.5环保相关风险

11.6融资策略分析

11.6.1项目包装融资

11.6.2高新技术融资

11.6.3BOT项目融资

11.6.4IFC国际融资

11.6.5专项资金融资

第十二章中国芯片行业典型项目投资建设案例深度解析

12.1消费电子领域的通用类芯片研发项目

12.1.1项目基本情况

12.1.2项目投资价值

12.1.3项目实施可行性

12.1.4项目实施主体

12.1.5项目投资计划

12.1.6项目效益估算

12.1.7项目实施进度

12.2蓝绿光LED芯片生产基地建设项目

12.2.1项目基本情况

12.2.2项目投资意义

12.2.3项目投资可行性

12.2.4项目实施主体

12.2.5项目投资计划

12.2.6项目收益测算

12.2.7项目实施进度

12.3电力电子器件生产线建设项目

12.3.1项目基本概况

12.3.2项目投资意义

12.3.3项目投资可行性

12.3.4项目实施主体

12.3.5项目投资计划

12.3.6项目效益评价

12.3.7项目实施进度

12.4大尺寸再生晶圆半导体项目

12.4.1项目基本情况

12.4.2项目投资意义

12.4.3项目投资可行性

12.4.4项目投资计划

12.4.5项目效益测算

12.4.6项目实施进度

12.5高端集成电路装备研发及产业化项目

12.5.1项目基本情况

12.5.2项目投资意义

12.5.3项目可行性分析

12.5.4项目投资计划

12.5.5项目效益测算

12.5.6项目实施进度

第十三章中国芯片产业未来前景展望

13.1中国芯片市场发展机遇分析

13.1.1中国产业发展机遇分析

13.1.2国内市场变动带来机遇

13.1.3芯片产业未来发展趋势

13.2中国芯片产业细分领域前景展望

13.2.1芯片材料

13.2.2芯片设计

13.2.3芯片制造

13.2.4芯片封测

13.32020-2026年中国芯片产业预测分析

13.3.12020-2026年中国芯片产业影响因素分析

13.3.22020-2026年中国芯片产业销售规模预测

第十四章2016-2019年中国芯片行业政策规划分析

14.1产业标准体系

14.1.1芯片行业技术标准汇总

14.1.2集成电路标准建设动态

14.2财政扶持政策

14.2.1基金融资补贴制度

14.2.2企业税收优惠政策

14.3监管体系分析

14.3.1行业监管部门

14.3.2并购重组态势

14.3.3产权保护政策

14.4相关政策分析

14.4.1智能制造政策

14.4.2智能传感器政策

14.4.3“互联网+”政策

14.4.4人工智能发展规划

14.4.5光电子芯片发展规划

14.4.6工业半导体扶持政策

14.5产业发展规划

14.5.1发展思路

14.5.2发展目标

14.5.3发展重点

14.5.4投资规模

14.5.5措施建议

14.6地区政策规划

14.6.1河北省集成电路发展实施意见

14.6.2安徽省半导体产业发展规划

14.6.3浙江省集成电路发展实施意见

14.6.4江苏省集成电路产业发展意见

14.6.5四川省集成电路产业培育方案

- 14.6.6杭州市集成电路产业专项政策
- 14.6.7昆山市半导体产业扶持意见
- 14.6.8无锡市集成电路产业发展政策
- 14.6.9成都市集成电路产业发展政策
- 14.6.10重庆市集成电路技术创新方案
- 14.6.11广州市集成电路产业发展政策
- 14.6.12深圳市集成电路产业发展政策
- 14.6.13厦门市集成电路产业实施细则

图表目录

图表集成电路与芯片

图表芯片的产业链结构

图表国内芯片产业链及主要厂商梳理

图表2019年全球芯片产品下游应用领域占比统计情况

图表全球芯片设计产业规模

图表2016-2019年全球芯片制造产能扩张情况

图表2016-2019年美国芯片市场规模增长情况

图表美国芯片行业领跑全球的独特发展模式分析

图表2019年全球IC公司市场份额

图表2016-2019年村田营收

图表2016-2019年TDK经营情况

图表2016-2019年国内生产总值及其增长速度

图表2016-2019年三次产业增加值占国内生产总值比重

图表2019年中国GDP核算数据

图表详见报告正文..... (GY YXY)

【简介】

中国报告网是观研天下集团旗下打造的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国芯片市场分析报告-行业发展现状与发展规划研究》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观

到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/ruanjian/468282468282.html>